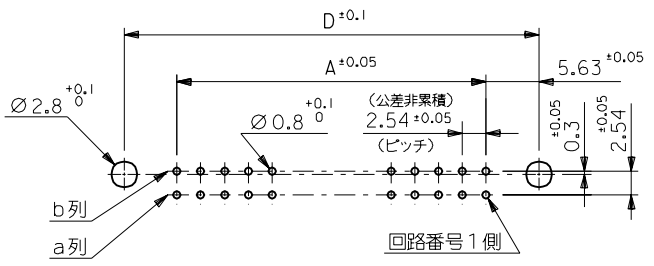
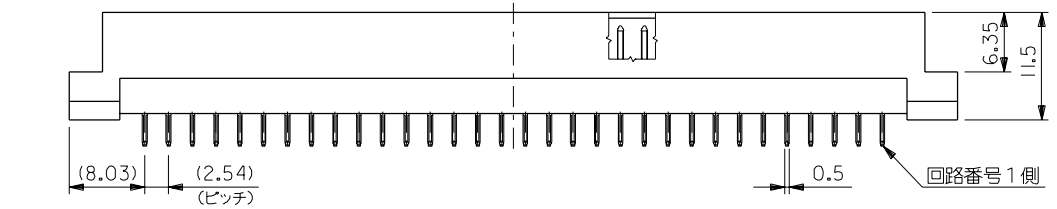
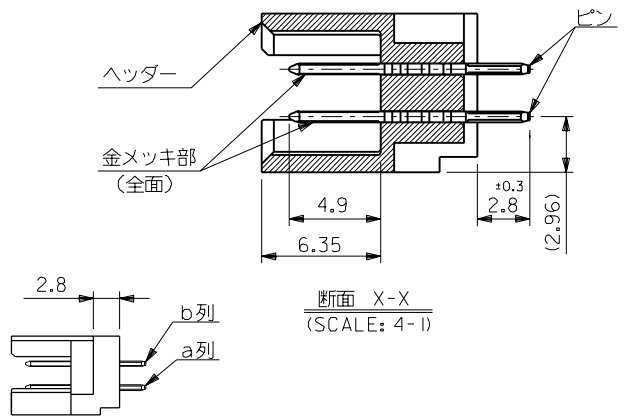
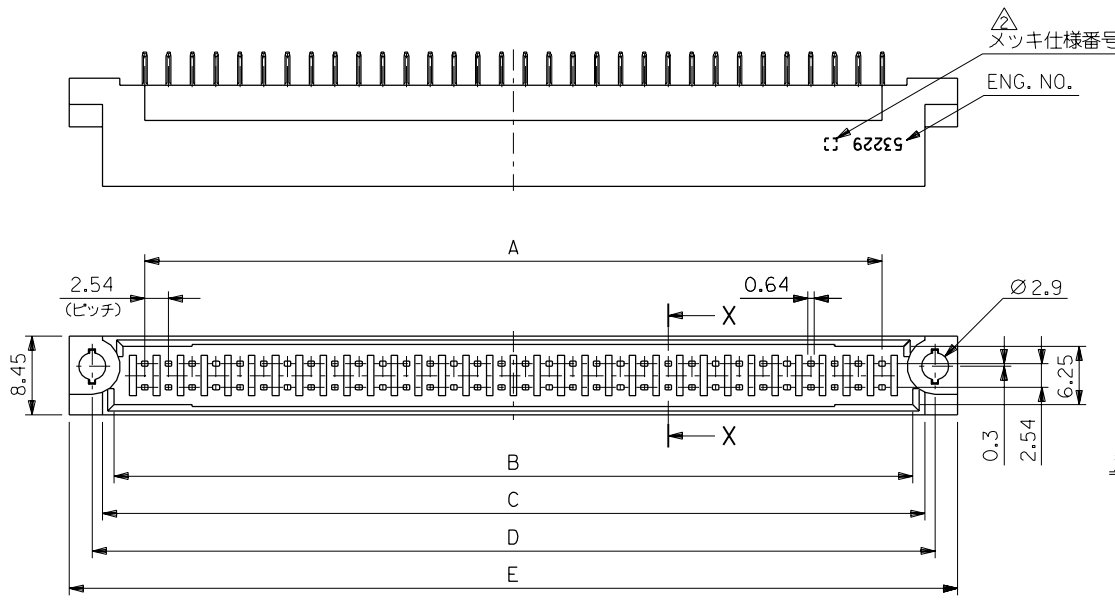


ENG. NO
SD-53229-*****

EDP NO.

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



基板穴推奨寸法 (基板厚: t=1.6)
(部品実装側)

注記

- 材質
ヘッダー-ガラス入り P.B.(白色) , UL94V-0
ピン : 黄銅 (t=0.58)
- メッキ仕様及び仕様番号

53229-***3	0.76	1.0	1.0	3
53229-***2	0.5			2
53229-***1	0.3			1
53229-***0	0.1			0
ENG. NO.	接点部 金メッキ [以上]	半田付け部 半田メッキ [以上]	下地メッキ ニッケルメッキ [以上]	メッキ 仕様番号

3. 嵌合相手: 52299, 52385, 52479, 52482 シリーズ

94.8	90	87.8	85.3	78.74	53229-064*	64
77.02	72.22	70.02	67.52	60.96	↑ -050*	50
69.4	64.6	62.4	59.9	53.34	↑ -044*	44
54.16	49.36	47.16	44.66	38.1	↑ -032*	32
38.92	34.12	31.92	29.42	22.86	↓ -020*	20
33.84	29.04	26.84	24.34	17.78	53229-016*	16
E	D	C	B	A	ENG. NO.	極数

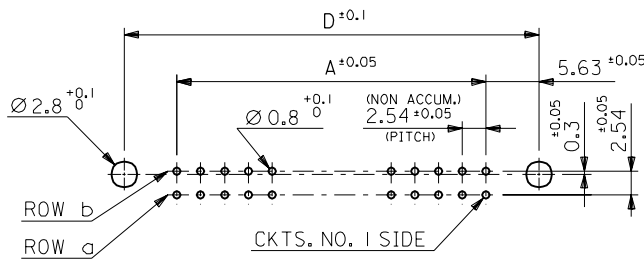
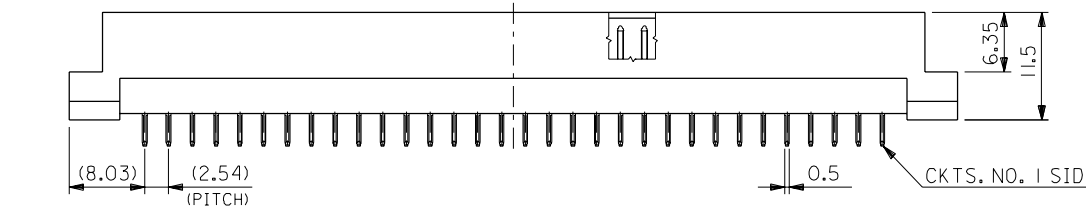
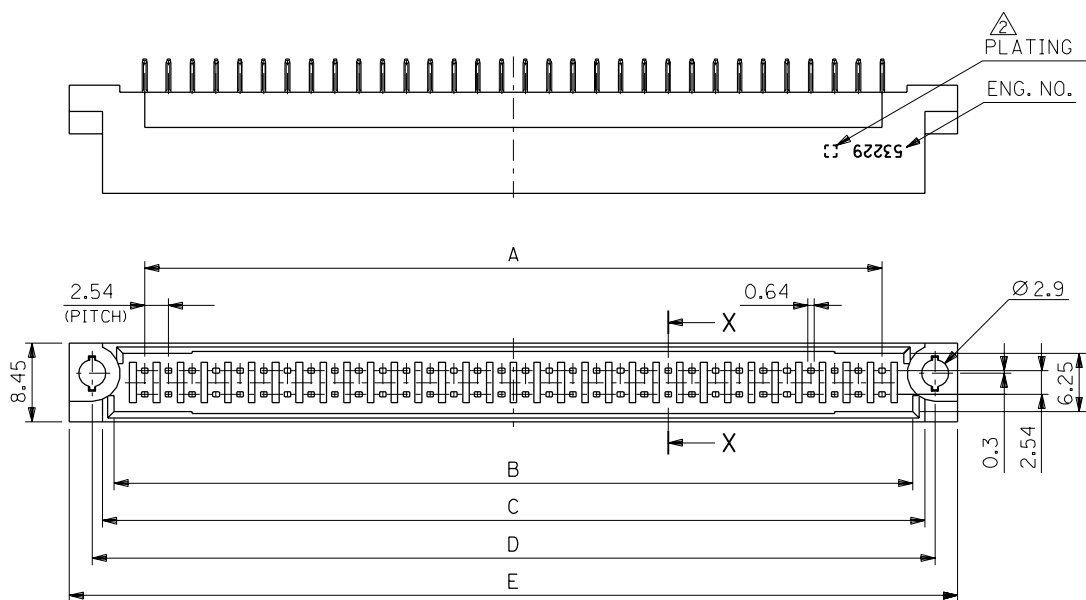
材料 MATERIAL		注記参照		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		注記参照		EDP. NO.	
適用電線範囲 WIRE RANGE		---		ENG. NO.	
30以上 OVER		---		SD-53229-****	
10以下 30未満 UNDER		---		REV	
10未満 UNDER		---		B	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISION RECORD		TITLE 名称 2.54 B TO B CONN. STRAIGHT HEADER ASS'Y (DUAL ROW)	
角度 ANGLE	±3°	B 変更 (J10138)	H.H	9/12/20	CHK'D BY
30以上 OVER	+0.3	A 変更 (J009811)	H.H	9/09/13	S.MOCHIZUKI
10以上 30未満 UNDER	+0.25	O 新規作成 (J00447)	S.M	9/04/20	DATE
10未満 UNDER	+0.2	記号 LTR	変更内容	DR. CHK.	DATE
		REVISION RECORD		APP'D BY	
		REVISION RECORD		尺度 SCALE 2 - 1	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

ENG. NO
SD-53229-****

EDP NO.

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



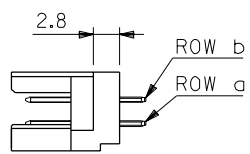
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (THK.=1.6)
(VIEW ON COMPONENT SIDE)

角度 ANGLE	±3°	B REVISED (J10138)	H.H	9/12/20
30以上 OVER	+0.3	A REVISED (J00981)	H.H	9/9/13
10以上 30未滿 UNDER	+0.25	O RELEASED(J00447)	S.M	9/0/20
10未滿 UNDER	+0.2	記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. 日付 DATE	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		

PLATING INDICACION NO.

ENG. NO.

GOLD PLATING AREA (WHOLE SURFACE)



SECT. X-X
(SCALE: 4-1)

NOTES:

1. MATERIAL

HEADER: GLASS FILLED P.B.T. (WHITE), UL94V-0
PIN: BRASS (t=0.58)

PLATING & PLATING INDICATION NUMBER

53229-***3	0.76	1.0	1.0	3
53229-***2	0.5			2
53229-***1	0.3			1
53229-***0	0.1			0
ENG. NO.	CONTACT AREA GOLD [µmMIN.]	SOLDER AREA TIN-LEAD [µmMIN.]	UNDER PLATE NICKEL [µmMIN.]	PLATING INDICATION NUMBER

3. MATE WITH: 52299, 52385, 52479, 52482 SERIES.

94.8	90	87.8	85.3	78.74	53229-064*	64
77.02	72.22	70.02	67.52	60.96	↑ -050*	50
69.4	64.6	62.4	59.9	53.34	↑ -044*	44
54.16	49.36	47.16	44.66	38.1	↑ -032*	32
38.92	34.12	31.92	29.42	22.86	↓ -020*	20
33.84	29.04	26.84	24.34	17.78	53229-016*	16
E	D	C	B	A	ENG. NO.	NO. OF CKTS.

材料 MATERIAL SEE NOTES

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

仕上げ FINISH SEE NOTES

EDP. NO.

適用電線範囲 WIRE RANGE

ENG. NO. REV B

被覆外径 INS. RANGE

SD-53229-****

DRAWN BY '90/4/20 S.MOCHIZUKI

TITLE 名称 2.54 B TO B CONN.

APP'D BY 尺度 SCALE 2 - 1

STRIGHT HEADER ASS'Y (DUAL ROW)